

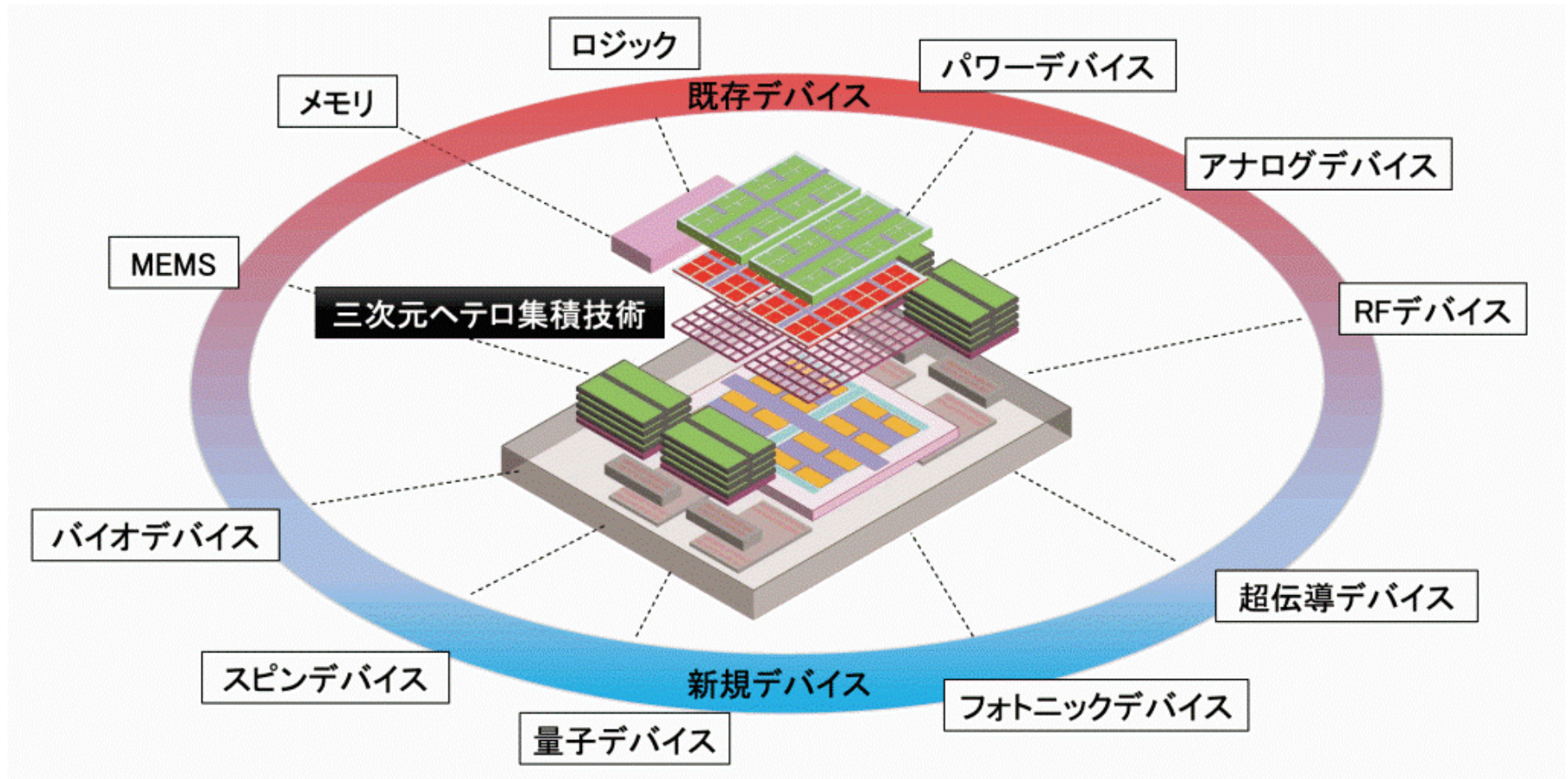
ヘテロ集積研究拠点 活動報告

井上 史大

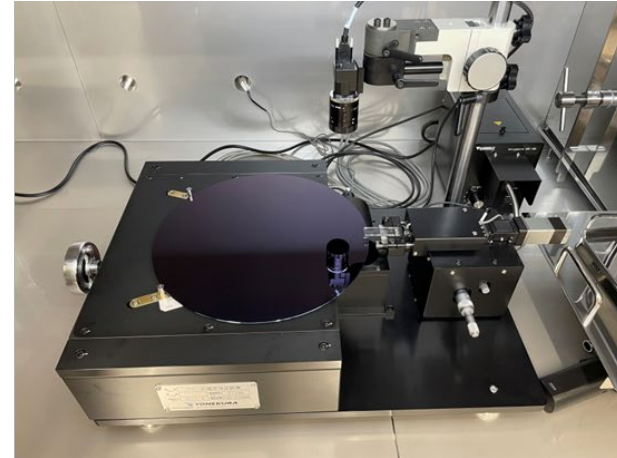


www.ynu.ac.jp

ヘテロデバイス集積化技術 — 高度なアプリケーションの実現に向けたソリューション —



ウエハ接合強度測定 国際規格化



Wafer Bond Strength Measurement by Double-cantilever Beam

Kick-off meeting

May 2024 Fumihiro Inoue

STANDARDS

CONNECT - COLLABORATE - INNOVATE - GROW - PROSPER

Timeline

STEP	2024												2025			
	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR				
Kick-Off			★													
Discussion of technical items			★		★											
SNARF Approval @JA-3D(SEMI)						●										
Develop the ballot							★									
Approval of ballot submission @SEMICON JAPAN								●								
Ballot voting											★					
Committee Adjudication @JA-3D(SEMI)																

5/17/2024

10

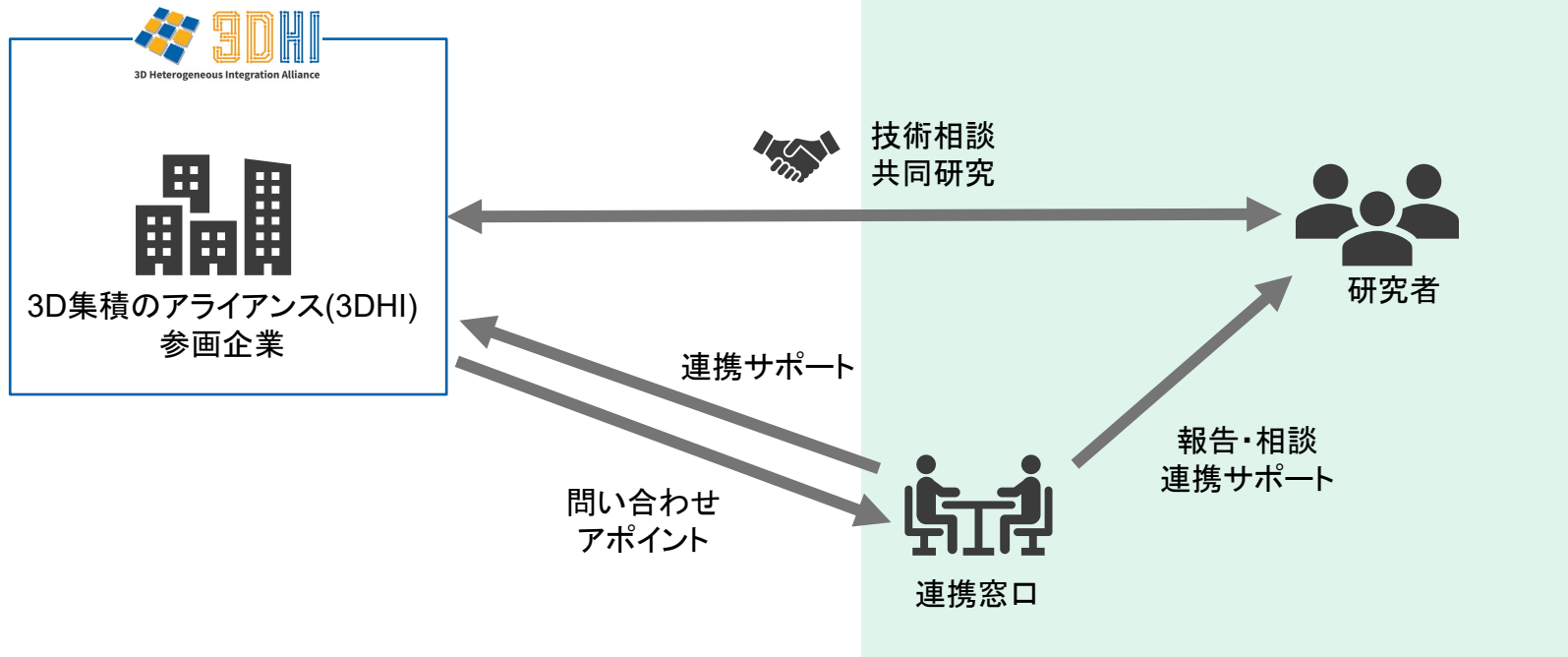
10社以上の国内外の半導体関連企業・研究機関が参加

社会的貢献: 産学連携



ヘテロ集積研究拠点

Research Center for Heterogeneous Integration



Thank you!



へテロ集積研究拠点

Research Center for Heterogeneous Integration

e-mail : inoue-fumihito-ty@ynu.ac.jp

Website : <https://rc-htr.ynu.ac.jp/>